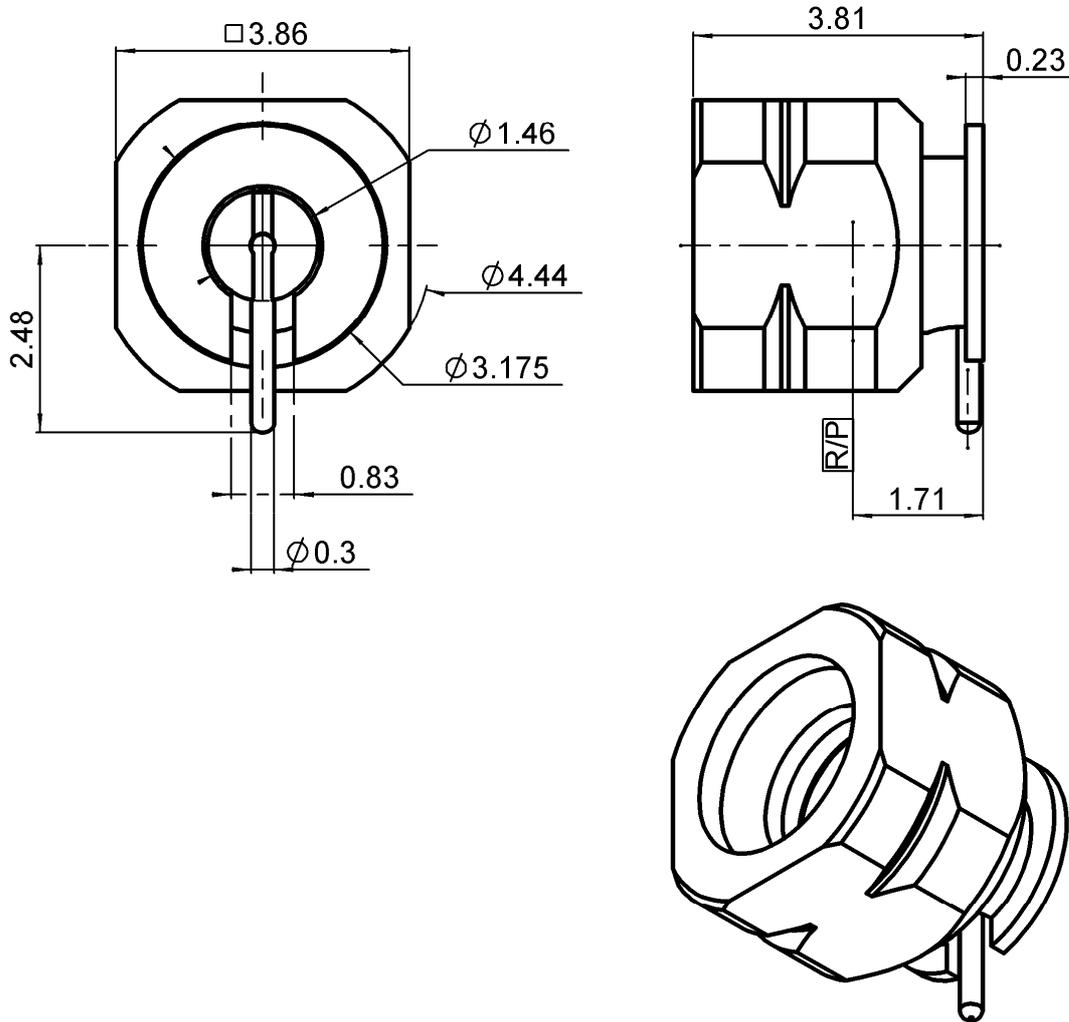


SMT PLUG RECEPTACLE

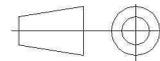
R201.508.000

FULL DETENT

Series : SMPM



All dimensions are in mm.



| COMPONENTS | MATERIALS | PLATING (µm) |
|----------------|------------------|------------------------|
| BODY | BERYLLIUM COPPER | GOLD 0.5 OVER NICKEL 2 |
| CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER | GOLD 0.5 OVER NICKEL 2 |
| OUTER CONTACT | - | - |
| INSULATOR | PEEK | - |
| GASKET | - | - |
| OTHERS PARTS | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Issue : 1042 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



SMT PLUG RECEPTACLE

R201.508.000

FULL DETENT

Series : SMPM

PACKAGING

SPECIFICATION

| Standard | Unit | Other |
|------------|-------------------|-------------------|
| 100 | 'W' option | Contact us |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ENVIRONMENTAL

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Impedance | 50 | Ω |
| Frequency | 0-20 | GHz |
| VSWR | ** + 0,0000 | x F(GHz) Maxi |
| Insertion loss | 0.12 | $\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi |
| RF leakage | - (NA) | - F(GHz)) dB Maxi |
| Voltage rating | 335 | Veff Maxi |
| Dielectric withstanding voltage | 500 | Veff mini |
| Insulation resistance | 5000 | M Ω mini |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| Operating temperature | -65/+165 | $^{\circ}$ C |
| Hermetic seal | NA | Atm.cm3/s |
| Panel leakage | NA | |

OTHER CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

** 1.15 to 12GHz

** 1.35 to 20GHz

***after soldering on PCB

MECHANICAL CHARACTERISTICS

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------|
| Center contact retention | | |
| Axial force – Mating end | 6.7*** | N mini |
| Axial force – Opposite end | 6.7*** | N mini |
| Torque | NA | N.cm mini |
| Recommended torque | | |
| Mating | NA | N.cm |
| Panel nut | NA | N.cm |
| Mating life | 100 | Cycles mini |
| Weight | 0,2700 | g |

Issue : 1042 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



SMT PLUG RECEPTACLE

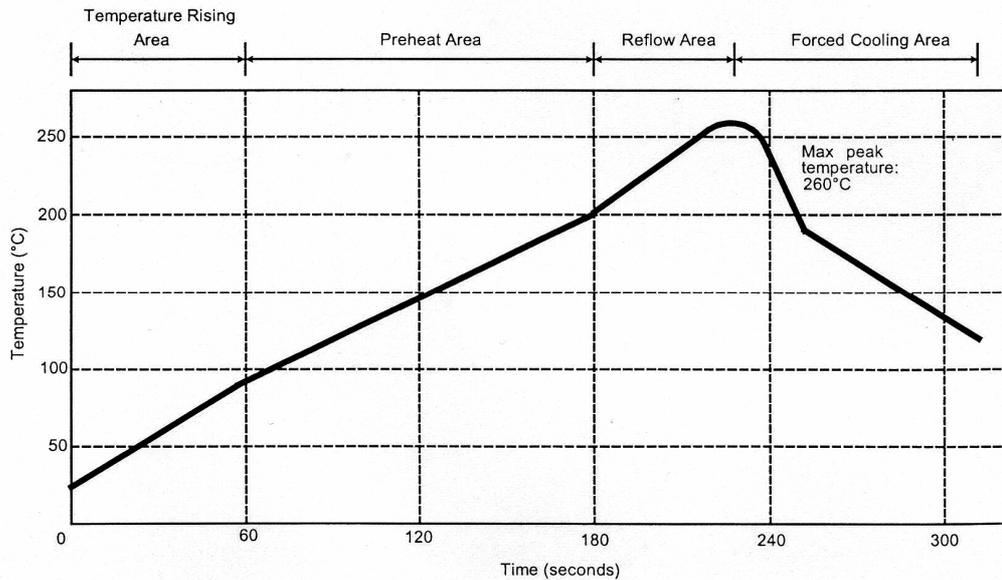
R201.508.000

FULL DETENT

Series : SMPM

SOLDER PROCEDURE

1. Deposition of solder paste 'Sn Ag4 Cu0.5' on mounting zone by screen printing application. We recommend a low residue flux.
We advise a thickness of 150 µm. Verify that the edges of the zone are clean.
2. Placement of the receptacle on the mounting zone with an automatic machine of 'pick and place' type.
Video camera is recommended for the positioning of the component. Adhesive agents must not be used on the receptacle.
3. Soldering by infra-red reflow.
Below, please find the typical profile to use.
4. Cleaning of printed circuit boards.
5. Checking of solder joints and position of the component by visual inspection.



| Parameter | Value | Unit |
|----------------------------------|----------|--------|
| Temperature rising Area | 1 - 4 | °C/sec |
| Max Peak Temperature | 260 | °C |
| Max dwell time @260°C | 10 | sec |
| Min dwell time @235°C | 20 | sec |
| Max dwell time @235°C | 60 | sec |
| Temperature drop in cooling Area | -1 to -4 | °C/sec |
| Max dwell time above 100°C | 420 | sec |

Issue : 1042 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



SMT PLUG RECEPTACLE

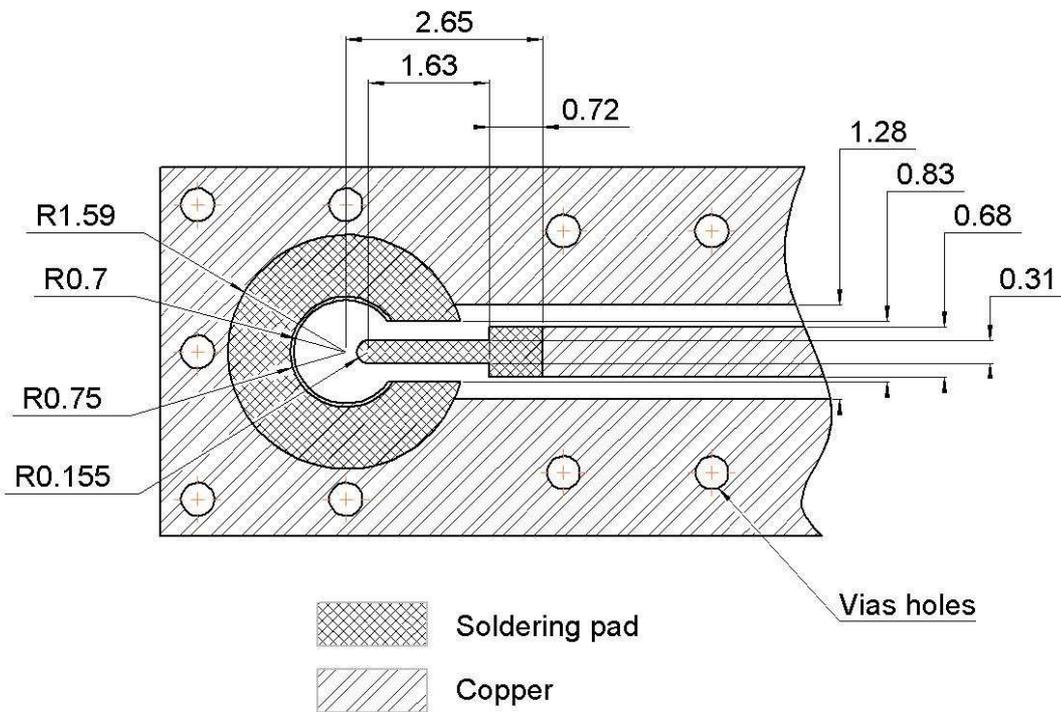
R201.508.000

FULL DETENT

Series : SMPM

RECOMMENDED PAD DIMENSIONS

Substrat: RT5880 thickness 0.254 mm, with copper layer 35µm on both sides.
 Add vias between both sides along upper ground plane according to engineering practise.



Issue : 1042 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9